

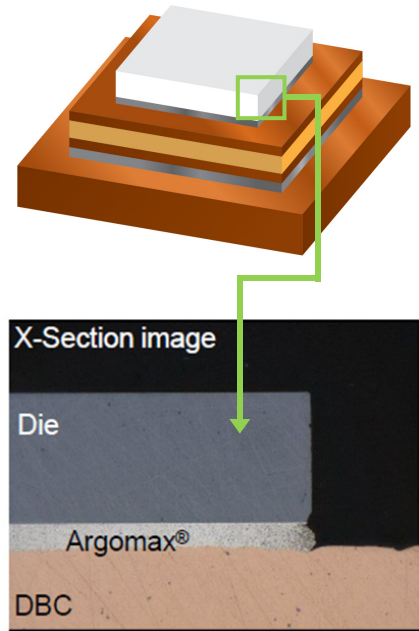
ARGOMAX® ACCULAM™ 8022

缩短工艺时间并更精确地放置 Argomax 烧结银膜

Argomax® 银烧结材料专为使用低压烧结工艺进行芯片粘接的大规模生产而设。

该预切银膜采用由麦德美爱法自主生产的高度工程化银基纳米颗粒配制而成。这些纳米银颗粒支持低压烧结，确保一致的粘接层厚度，并实现高效率的生产。

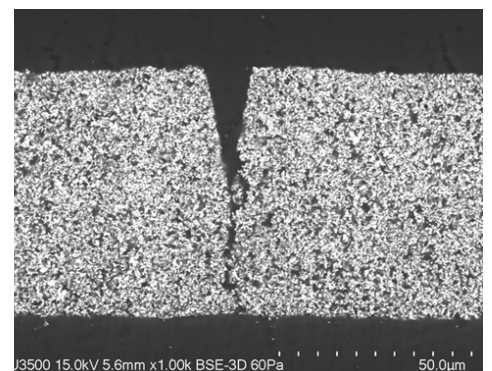
Argomax AccuLam™是一种预切割银膜，可精确且能重复地将Argomax银层从底膜衬垫上移除，并根据客户尺寸定制。AccuLam 8022非常适合用于芯片粘接或间隔块粘接应用。



在烧结前，将Argomax粘附到芯片和DBC上，以展示使用AccuLam时Argomax的放置精度。

主要特性优点

- 纯银粘合层，性能高，可靠性强
- 高导热和导电率使其相比传统焊料具有更高的电流承载能力
- AccuLam预切割银膜相比标准Argomax膜产品可实现更低的生产总成本
- 可烧结于银和金表面
- 适配工艺尺寸要求的特有图案银膜形式
- 一致的粘接层厚度控制



预切割的Argomax银膜能够更精确地将Argomax放置到芯片或间隔层上。该材料经过预切割处理，可实现从背衬/载体银膜上更一致的释放。

ARGOMAX[®] ACCULAM[™] 8022

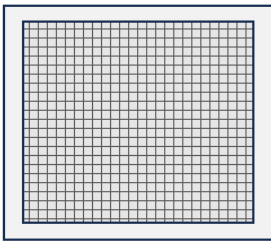
缩短工艺时间并更精确地放置 Argomax 烧结银膜

其他关键特性/优点

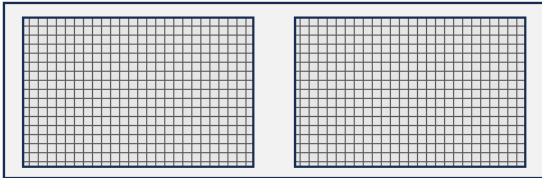
- 预切银膜可精确附着于芯片或间隔块上
- 无需印刷和干燥设备:与烧结银膏相比,成本更低
- 室温下存储时间长,使用更加便利
- 可烧结至银和金表面,提供最大的应用灵活性

ARGOMAX[®] ACCULAM[™] 8022 薄膜优势

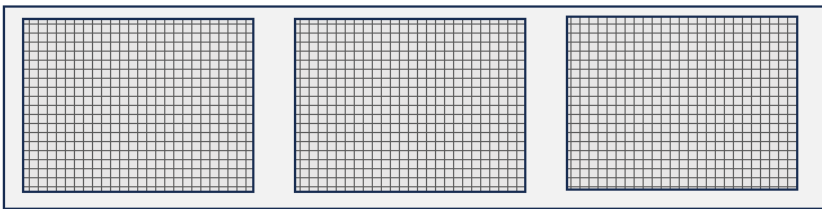
- Argomax AccuLam提供三种片材尺寸选择
- 网格区域可根据客户要求定制,以满足芯片尺寸的应用需求
- Argomax AccuLam膜提供65μm厚度,适用于20μm的标准粘接层厚度
- 其他片材尺寸可按需求定制,但需经审批确认



整张尺寸为 97 x 97



整张尺寸为 205 x 63



整张尺寸为 248 x 67

*请联系麦德美爱法获取布局信息

